

# Buchsenleisten RM 1,27mm, gerade/gewinkelt, 2-reihig - BH 3,4/4,3mm

## Female Headers, 1.27mm Pitch, Straight/Right-Angled, 2 Rows - 3.4/4.3mm Profile

### Technische Daten / Technical Data

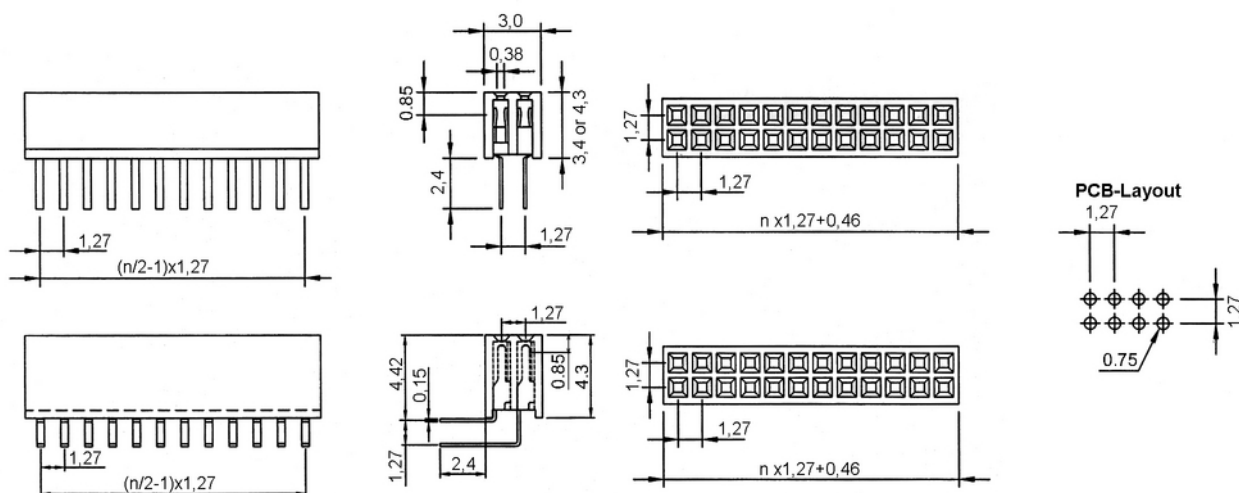
|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Isolierkörper         | Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0          |
| Insulator             | Thermoplastic, rated UL94 V-0                        |
| Kontaktmaterial       | Kupferlegierung                                      |
| Contact Material      | Copper alloy                                         |
| Kontaktfläche         | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)     |
| Contact Surface       | Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm) |
| Lötbarkeit            | IEC 60512-12A                                        |
| Solderability         | IEC 60512-12A                                        |
| Durchgangswiderstand  | < 20mΩ                                               |
| Contact Resistance    | < 20mΩ                                               |
| Isolationswiderstand  | > 1000MΩ                                             |
| Insulation Resistance | > 1000MΩ                                             |
| Spannungsfestigkeit   | 500V <sub>AC</sub>                                   |
| Test Voltage          | 500V <sub>AC</sub>                                   |
| Nennstrom             | 1A                                                   |
| Current Rating        | 1A                                                   |
| Temperaturbereich     | -40°C ... +105°C                                     |
| Temperature Range     | -40°C ... +105°C                                     |
| Verarbeitung          | Wellen- oder Reflow-Lötverfahren                     |
| Processing            | Wave or reflow soldering                             |



© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker Serie:

Mate with Connector Series:

**712** oder / orDoppelfederkontakte für Vierkantstifte  
0,40mm.Dual beam contacts accept square pins  
0.40mm.

| Series     | Contacts*                                      | Type*                                                                                                                   | Height*                                                                        | Plating*                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>605</b> | <b>100</b><br>006-100 Zweireihig<br>Double row | <b>2</b><br>1 Gerade<br>Straight<br>2 Gewinkelt (nur Bauhöhe 4,3mm)<br>Right-angled (only available with 4.3mm profile) | <b>2</b><br>1 Bauhöhe 3,4mm<br>Height 3.4mm<br>2 Bauhöhe 4,3mm<br>Height 4.3mm | <b>50</b><br>00 Vergoldet<br>Gold plated<br>50 Verzinnt<br>Tin plated<br>60 Sel. Au/Sn<br>Duplex plating |

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0  
FAX +49 5223 98507-50

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL [sales@wppro.com](mailto:sales@wppro.com)  
WEBSITE [www.wppro.com](http://www.wppro.com)

## Informationen zum Wellen-Lötverfahren

### Wave Soldering Information

## Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

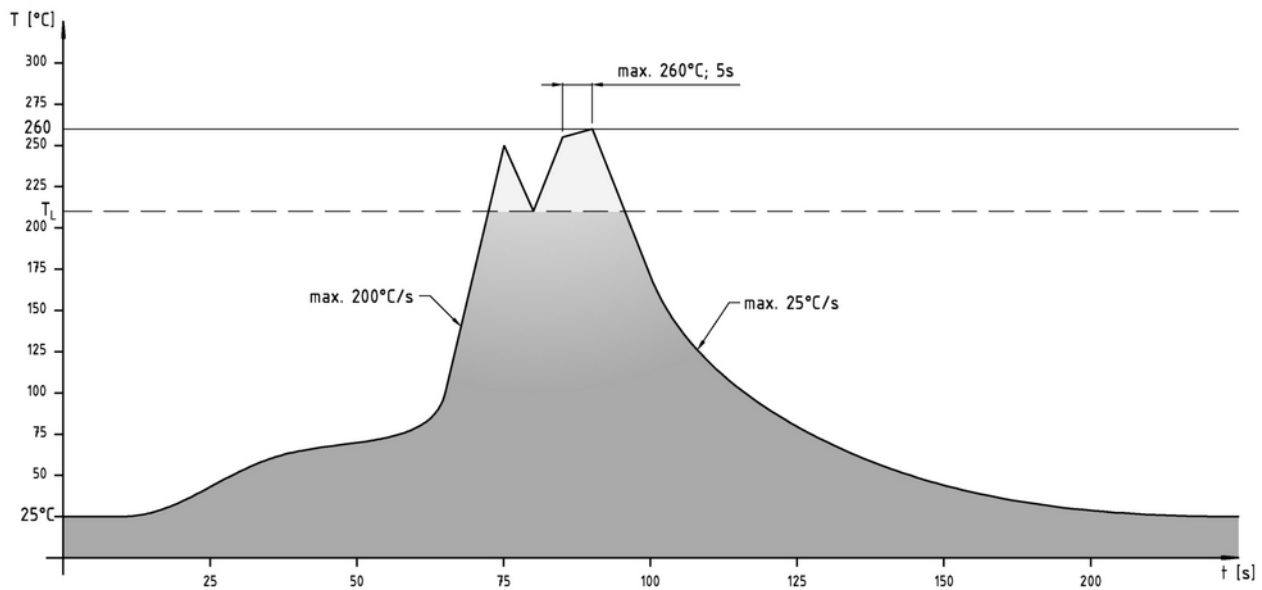
### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

Recommended wave soldering profile:



## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft                    | Kennwert     |
|--------------------------------------|--------------|
| Temperatur Minimum $T_{Smin}$        | 150°C        |
| Temperatur Maximum $T_{Smax}$        | 200°C        |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$          | 60-180s      |
| Temperatur Lötbereich $T_L$          | 217°C        |
| Verweildauer oberhalb $T_L$          | 60-180s      |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3°C / s |
| Höchsttemperatur $T_P$               | 260°C ±5     |
| Dauer Höchsttemperatur               | 20-40s       |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s      |
| Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$  | Max. 8 min   |

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature                      | Key Values   |
|--------------------------------------|--------------|
| Minimum Temperature $T_{Smin}$       | 150°C        |
| Maximum Temperatur $T_{Smax}$        | 200°C        |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$       | 60-180s      |
| Soldering Range Temperature $T_L$    | 217°C        |
| Duration above $T_L$                 | 60-180s      |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3°C / s |
| Peak Temperature $T_P$               | 260°C ±5     |
| Duration Peak Temperature            | 20-40s       |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s      |
| Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$     | Max. 8min    |

